

2021年度 第2四半期 決算説明資料

2021.10.21

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

(単位：百万円)	FY2021	FY2021	QoQ		FY2020	YoY	
	2Q	1Q	差額	(%)	2Q	差額	(%)
売上高	67,791	48,291	19,500	40.4%	47,561	20,230	42.5%
売上総利益	40,415	29,427	10,988	37.3%	27,418	12,997	47.4%
GP率	59.6%	60.9%	-1.3p	-	57.6%	2.0p	-
販売管理費	15,902	13,982	1,920	13.7%	13,342	2,560	19.2%
営業利益	24,513	15,444	9,068	58.7%	14,076	10,437	74.1%
経常利益	25,144	14,750	10,394	70.5%	14,008	11,136	79.5%
経常利益率	37.1%	30.5%	6.6p	-	29.5%	7.6p	-
税前利益	25,119	14,716	10,403	70.7%	14,007	11,111	79.3%
純利益	18,010	10,581	7,429	70.2%	10,127	7,883	77.8%

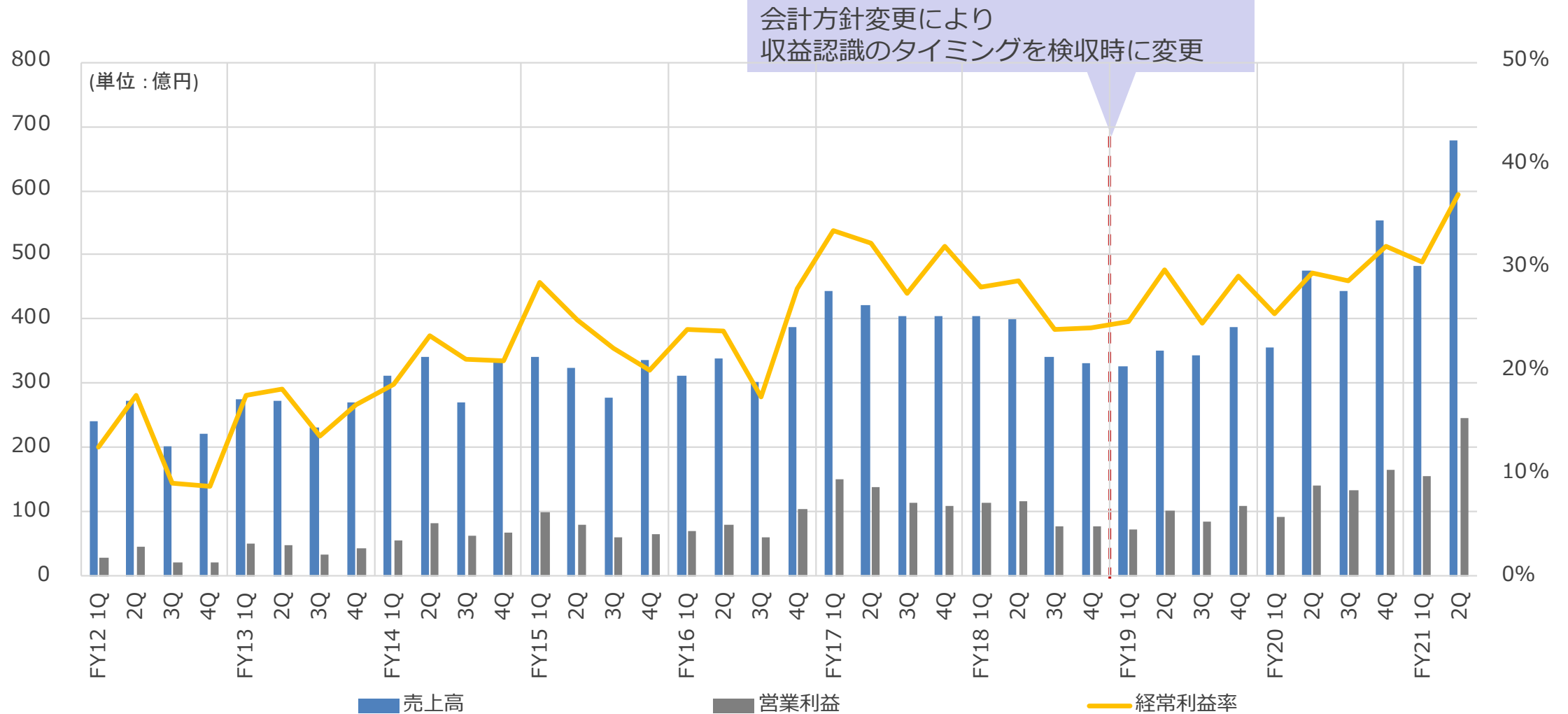
売上高： YoY、QoQ 共に高水準の製品出荷と検収の進捗により大幅増
 GP率： QoQ 主に製品構成の変化により低下
 販売管理費： QoQ 主に業績連動費用が増加

(単位：百万円)	FY2021 1H	FY2020 1H	YoY	
			差額	(%)
売上高	116,082	83,215	32,867	39.5%
売上総利益	69,843	48,824	21,019	43.0%
GP率	60.2%	58.7%	1.5p	-
販売管理費	29,885	25,465	4,420	17.4%
営業利益	39,958	23,359	16,598	71.1%
経常利益	39,895	23,125	16,771	72.5%
経常利益率	34.4%	27.8%	6.6p	-
税前利益	39,835	23,091	16,744	72.5%
純利益	28,592	16,600	11,992	72.2%

売上高： YoY 高水準の製品出荷と検収の進捗により大幅増

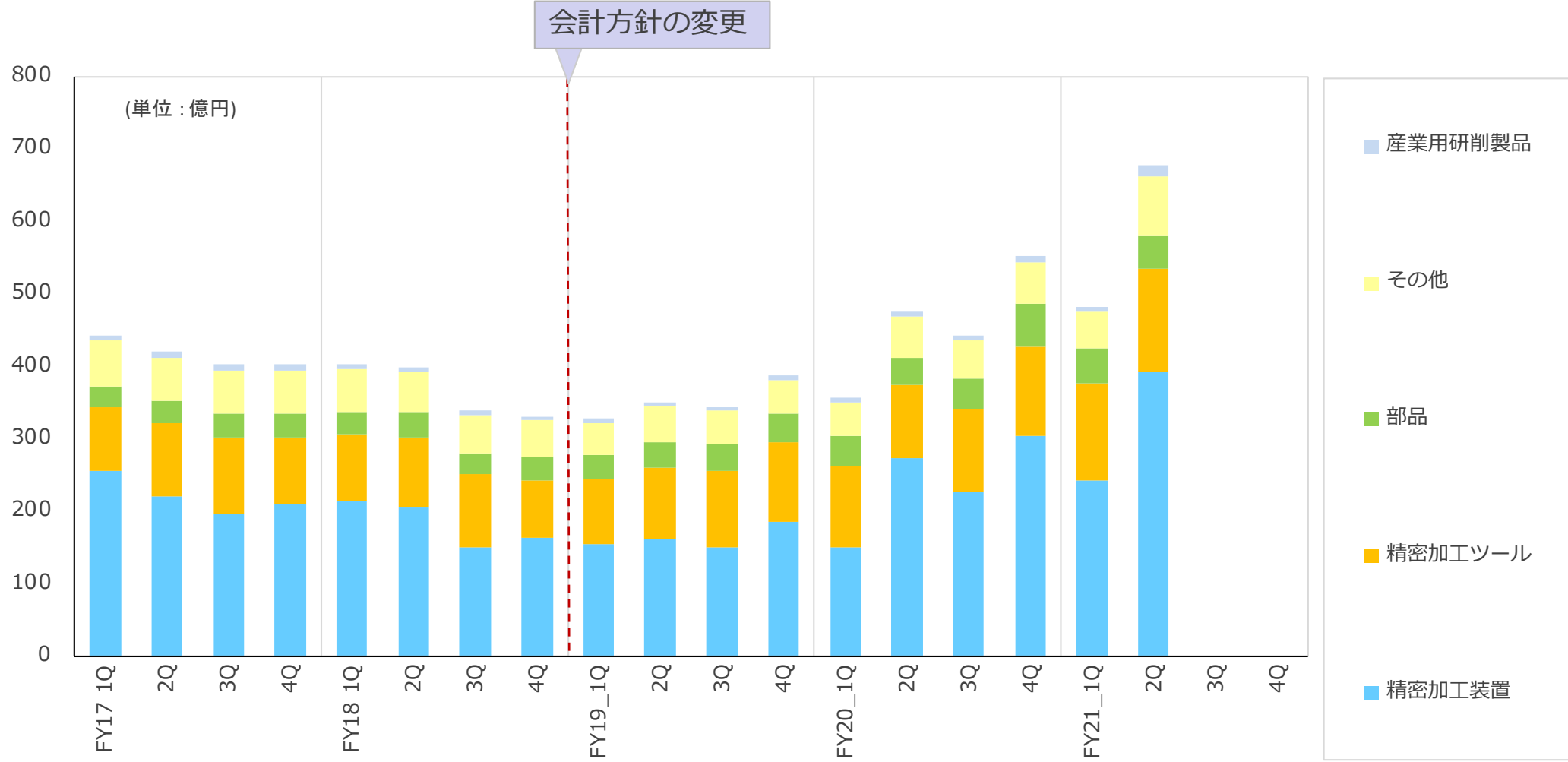
GP率： YoY 為替影響や改善活動などにより上昇

販売管理費： YoY 主に人件費および研究開発費が増加



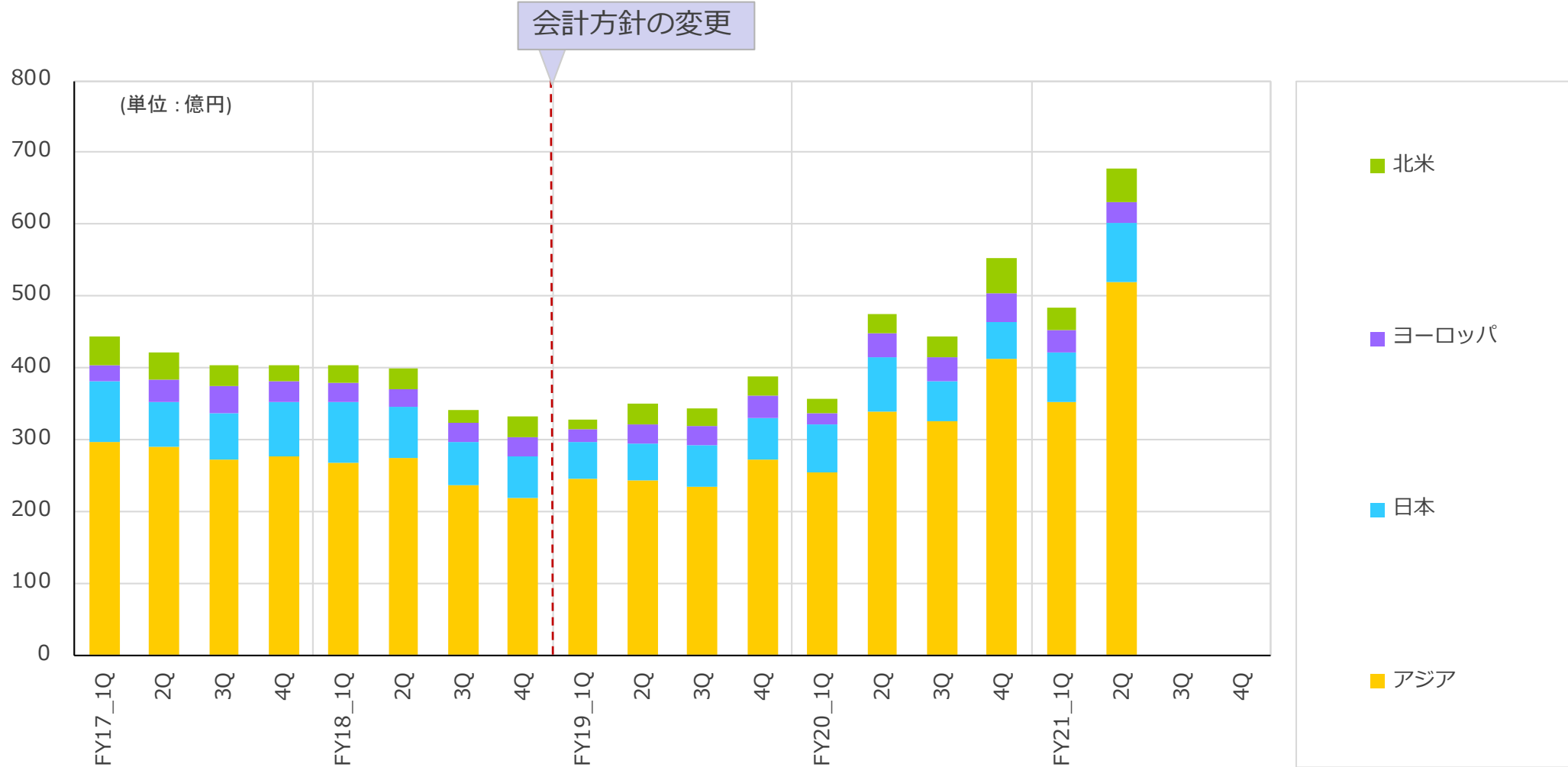
業績および利益率は過去最高（四半期ベース）
 (FY21_2Q 営業利益率36.2% 経常利益率37.1% 純利益率26.6%)

製品群別売上高 四半期推移



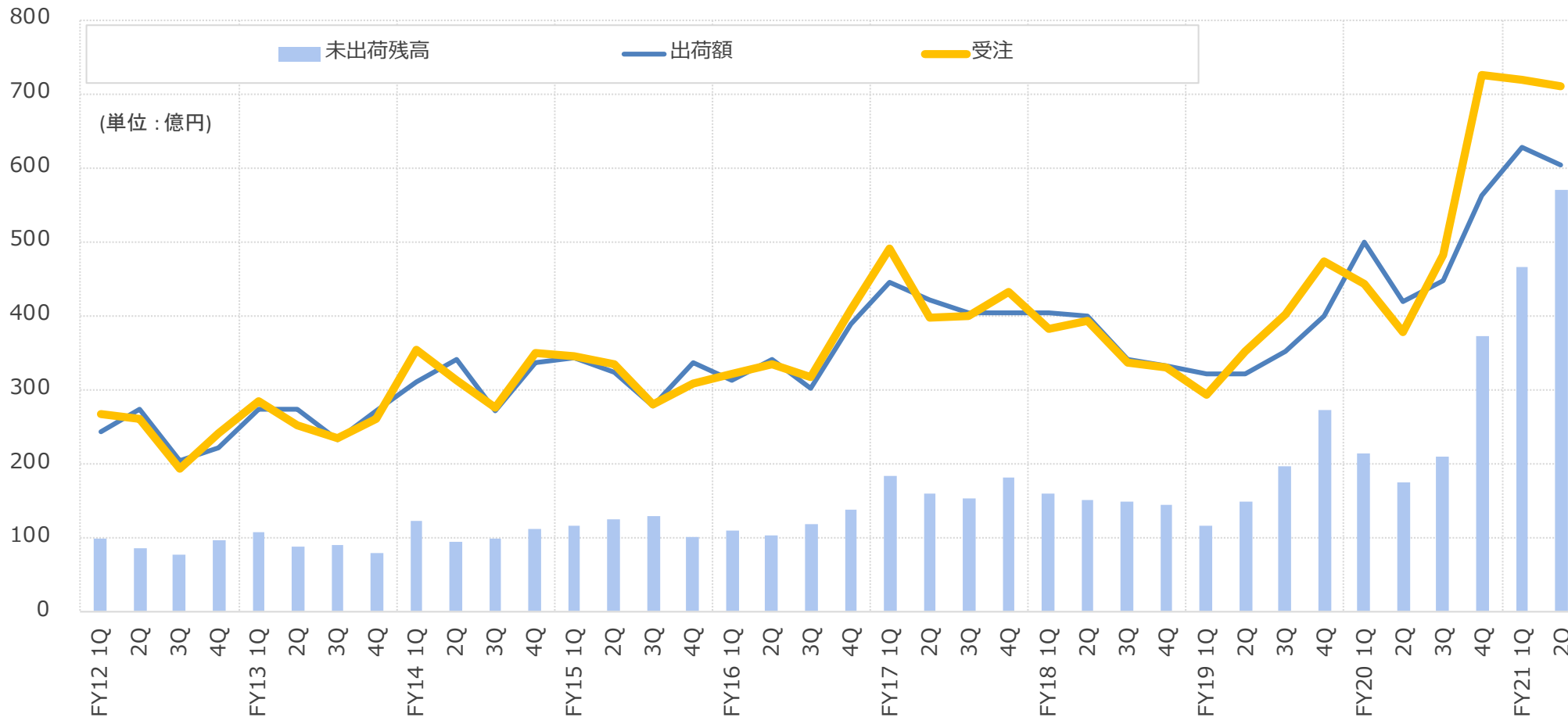
※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

地域別売上高 四半期推移



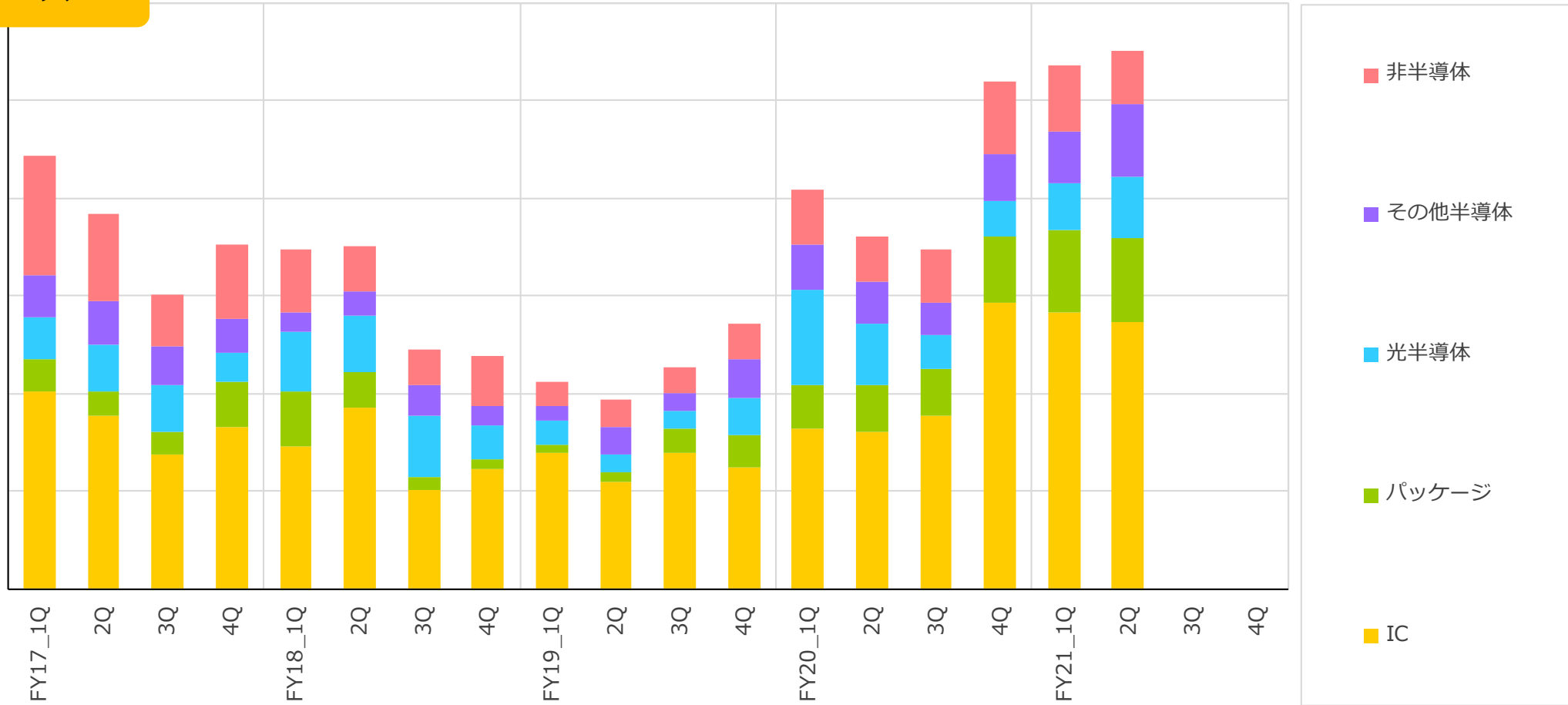
FY21_2Q 海外売上高比率 87.8%

出荷額ベース



FY21_2Q 受注高 約709億円、出荷額 約604億円、未出荷残高 約570億円

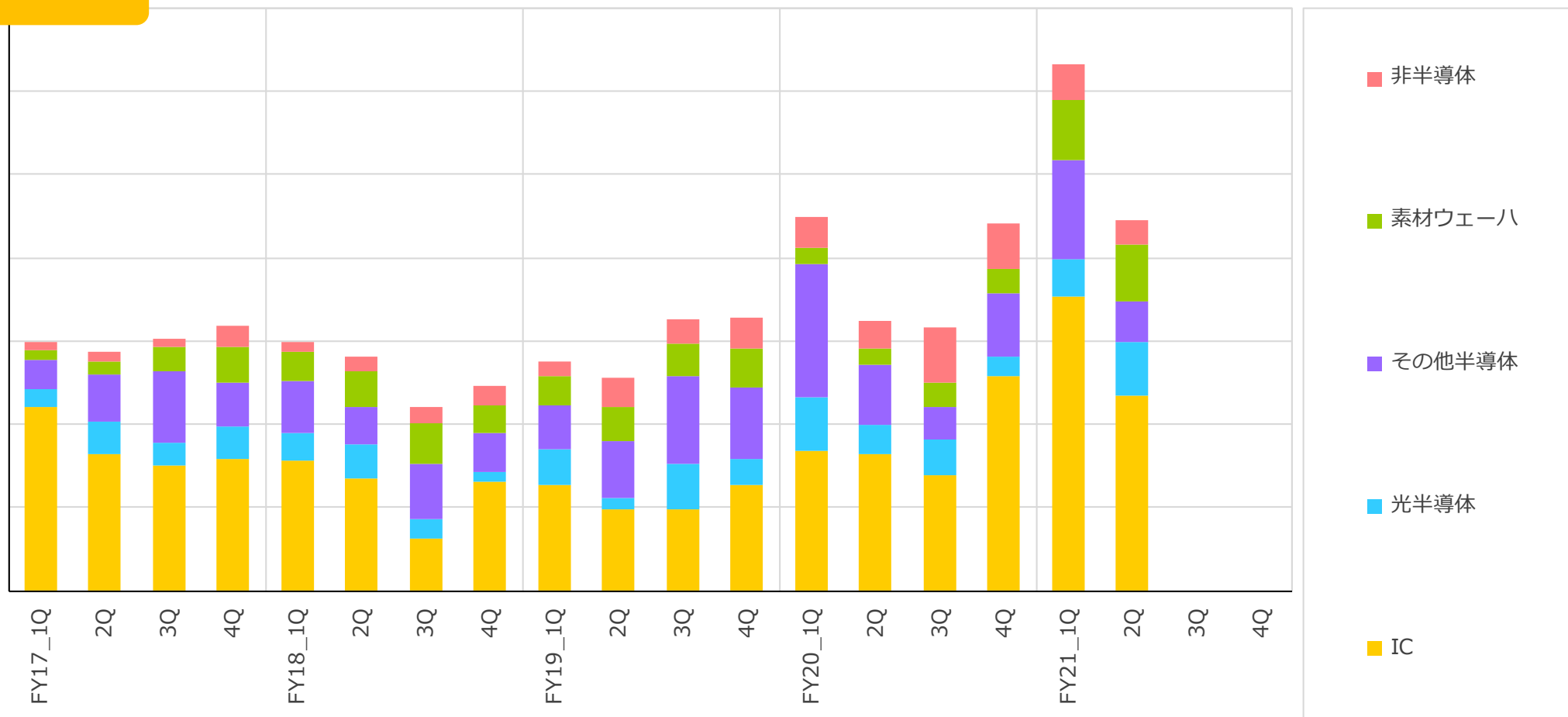
出荷額ベース



QoQ
YoY

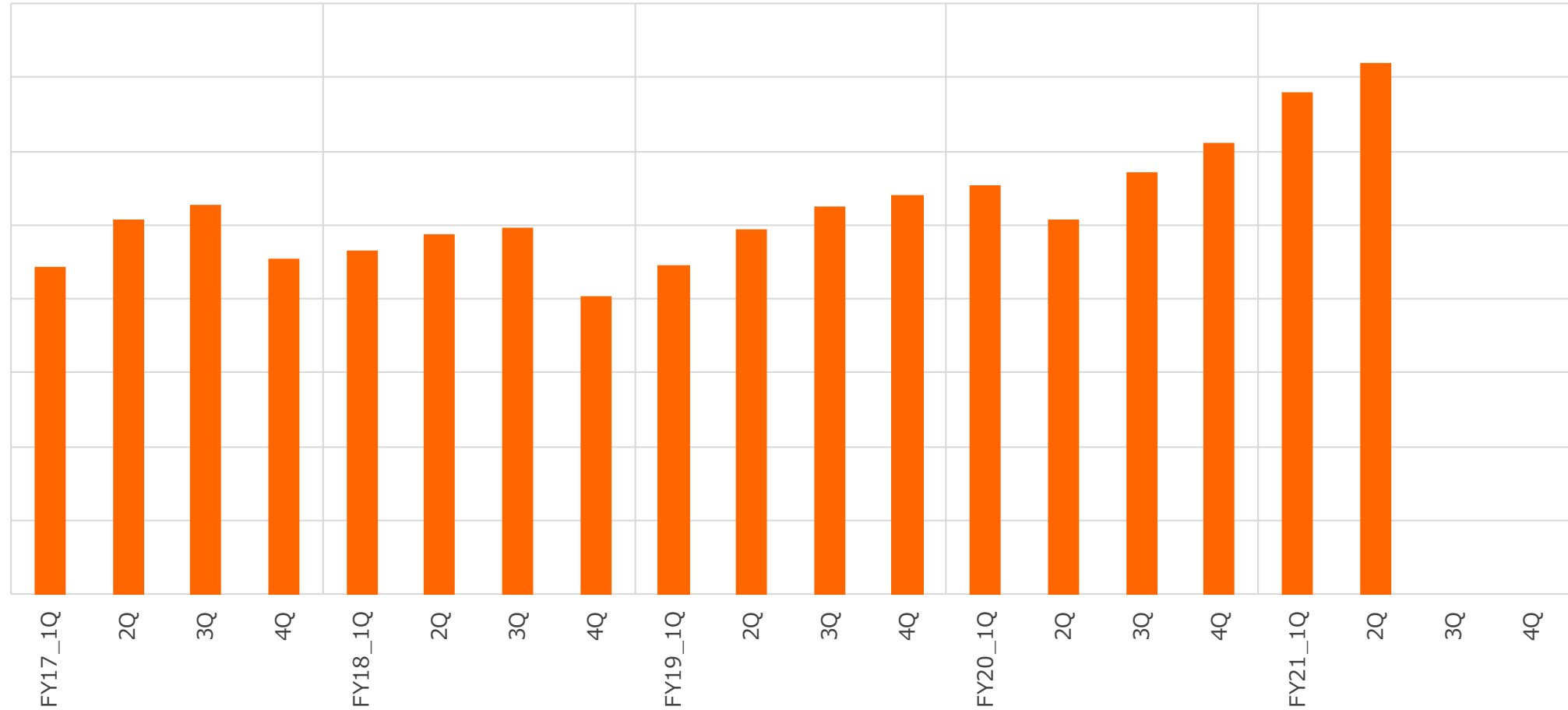
堅調な I Cに加え、パワー半導体（その他半導体）、光半導体が増加
半導体需要の拡大を背景に、7四半期連続で前年同期を上回る

出荷額ベース



QoQ ICやパワー半導体（その他半導体）の出荷が集中した前四半期からの反動もあり減少

YoY パワー半導体（その他半導体）が集中した前年同期と比べると、幅広い用途での出荷となった



高い設備稼働率などを背景に消耗品の出荷は堅調（過去最高更新）

(単位：百万円)	FY2021 2Q	FY2021 1Q	差額
現金及び預金	112,884	101,019	11,865
受取手形・売掛金	37,610	31,742	5,868
たな卸資産	61,700	62,771	-1,071
流動資産	218,314	199,568	18,745
有形固定資産	113,956	109,399	4,557
固定資産	126,264	120,919	5,345
総資産	344,578	320,487	24,091
流動負債	82,819	76,593	6,226
固定負債	740	717	23
負債合計	83,559	77,311	6,249
純資産	261,018	243,176	17,842
負債純資産合計	344,578	320,487	24,091
自己資本比率	75.4%	75.5%	-0.1p

総資産：検収・出荷動向を反映し現預金・売掛金が増加 他、工場新棟竣工で固定資産が増加
 負債：主に未払法人税等の増加によるもの
 純資産：主に利益剰余金の増加によるもの

(単位：百万円)	FY2021 1H	FY2020 1H	差額
営業キャッシュ・フロー	31,820	22,767	9,053
税前当期利益	39,835	23,091	16,744
減価償却	3,713	3,179	533
売上債権の増減	-3,933	-4,531	598
たな卸資産の増減	-4,713	-1,864	-2,849
仕入債務の増減	1,776	264	1,511
法人税支払い	-12,998	-3,310	-9,688
その他営業CF	8,140	5,937	2,203
投資キャッシュ・フロー	-9,671	-339	-9,332
有形固定資産の取得	-9,615	-8,524	-1,091
その他投資CF	-55	8,184	-8,241
フリー・キャッシュ・フロー	22,149	22,427	-279
財務キャッシュ・フロー	-20,026	-12,330	-7,696
配当金支払い	-20,218	-12,471	-7,746
現金同等物増減	3,075	10,473	-7,398
期首残高	109,809	79,782	30,027
期末残高	112,884	90,256	22,629

- 営業CF・・・約318億円 資金増加
主に税前当期利益の増加によるもの

- 投資CF・・・約96億円 資金減少
主に工場の新棟建設に伴う支払い
(8月桑畑工場新棟竣工)

- フリー・キャッシュ・フロー
約221億円の資金増加

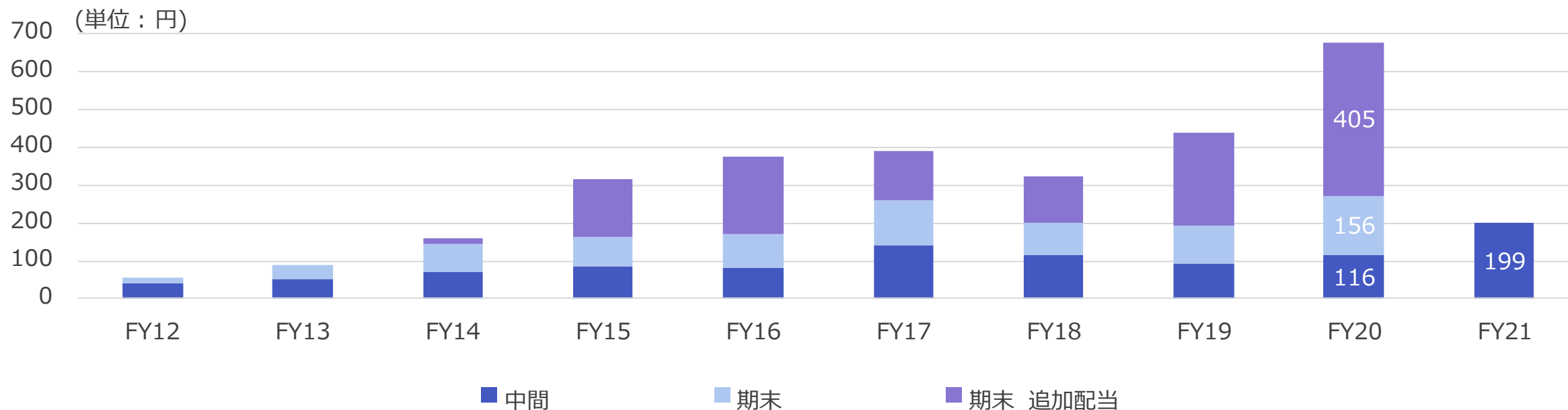
- 財務CF・・・約200億円 資金減少
主に配当の金支払い

→ 9月末の現金残高 約1,128億円

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 期末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



今期予想

FY21 中間 199円 期末 未定

(単位：億円)

今回予想

	FY20 1Q	2Q	3Q	4Q	FY21 1Q	2Q	3Q
売上高	357	476	444	552	483	678	595
営業利益	93	141	133	164	154	245	188
経常利益	91	140	128	177	148	251	197
純利益	65	101	90	135	106	180	140
営業利益率	26.0%	29.6%	30.0%	29.7%	32.0%	36.2%	31.7%
経常利益率	25.6%	29.5%	28.7%	32.1%	30.5%	37.1%	33.1%
純利益率	18.2%	21.3%	20.3%	24.4%	21.9%	26.6%	23.5%
出荷額	499	418	446	562	627	604	620

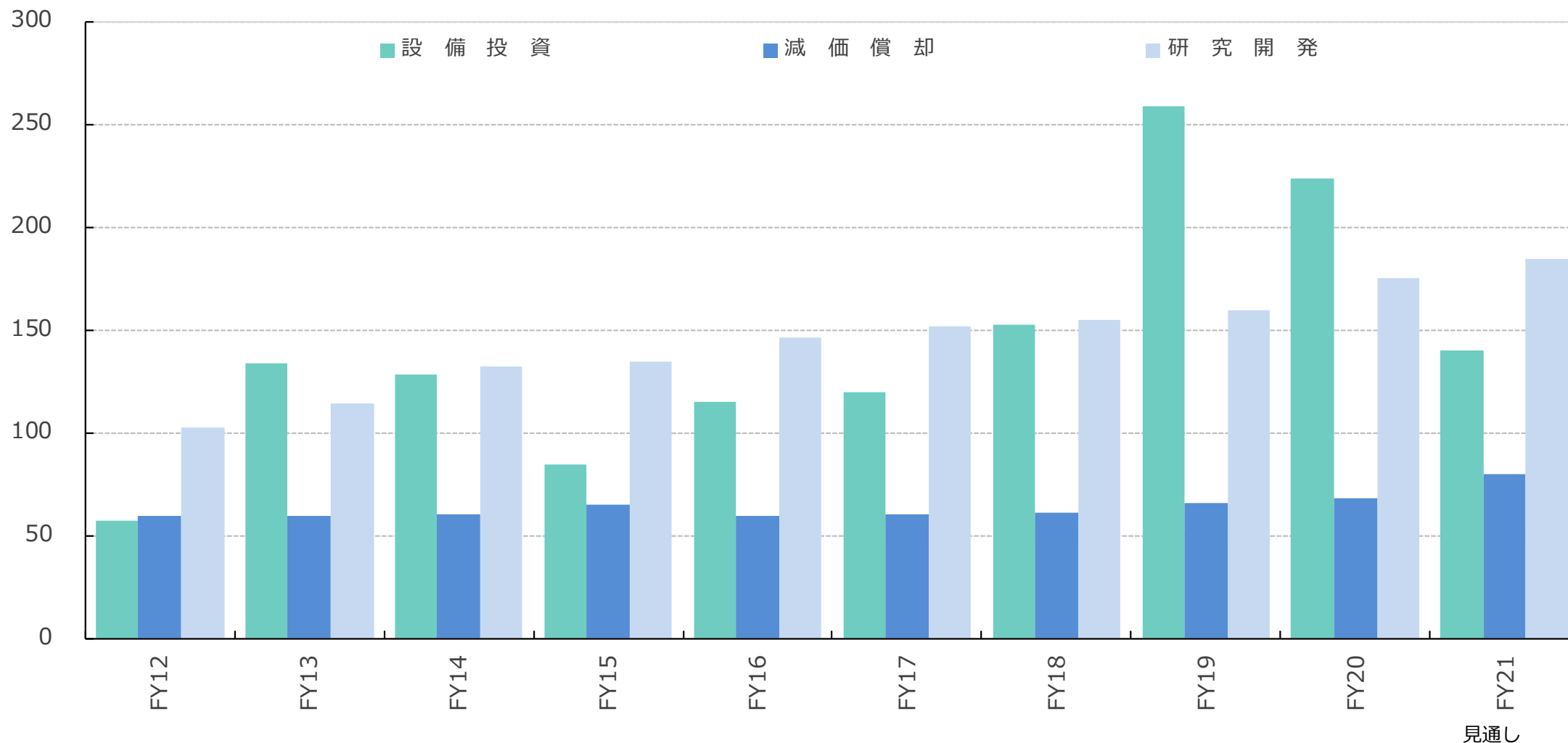
※億円未満 四捨五入

想定為替レート
為替感応度（年換算）

US\$: 105円 Euro : 125円
US\$: 約12億円 Euro : 約3千万円

出荷額ベース

QoQ		FC FY21_3Q
ダイサ	ブレードダイサ	5%
	レーザソー	40%
		20%
	薄化DGP	20%
	薄化以外	0%
グラインダ	10%	
精密加工装置		15%
精密加工ツール		0%
その他		-20%

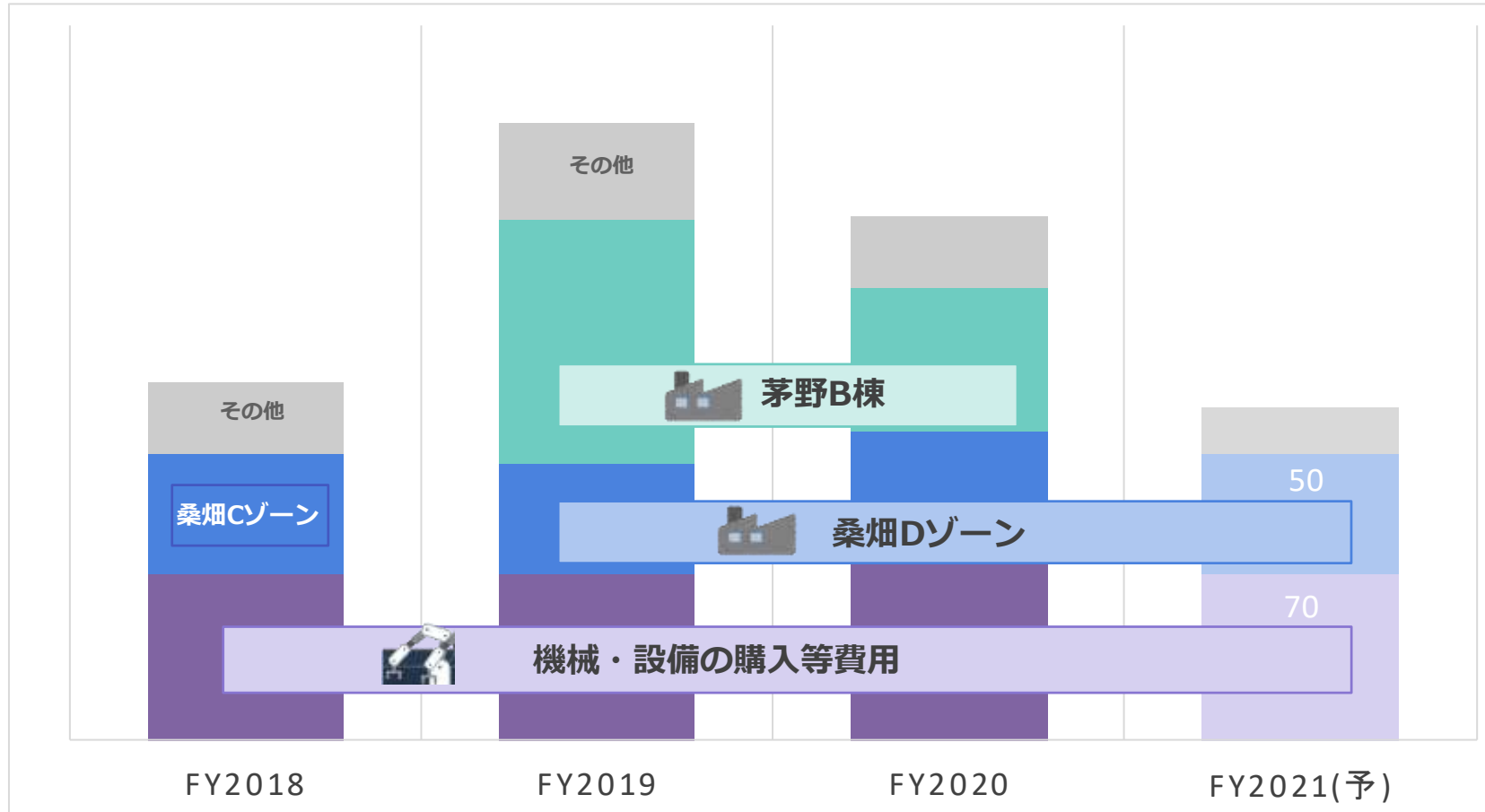


FY21見通し

設備投資：工場新棟建設（桑畑）を含む
 減価償却：前年度より償却増加の見込み
 研究開発：積極的な研究開発を実施予定

140億円程度 (FY20実績 223億円)
 80億円前後 (FY20実績 68億円)
 185億円前後 (FY20実績 175億円)

単位：億円



FY21見通し

機械・設備の購入等費用

70億円程度

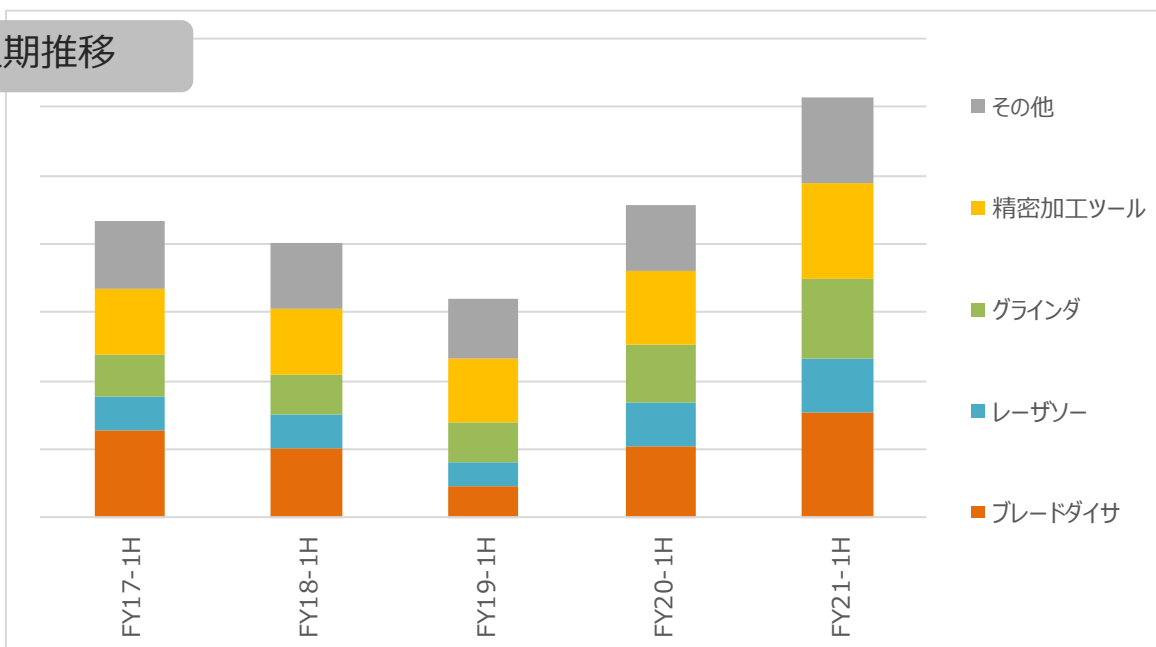
桑畑工場Dゾーン：竣工時、最終支払い予定 50億円前後

■ 出荷動向

装置 ダイサ、グラインダ共に高水準の出荷が継続
量産向けを中心に、幅広い用途で需要が旺盛

消耗品 顧客の高い設備稼働率を背景に出荷は堅調に推移

出荷額 上期推移

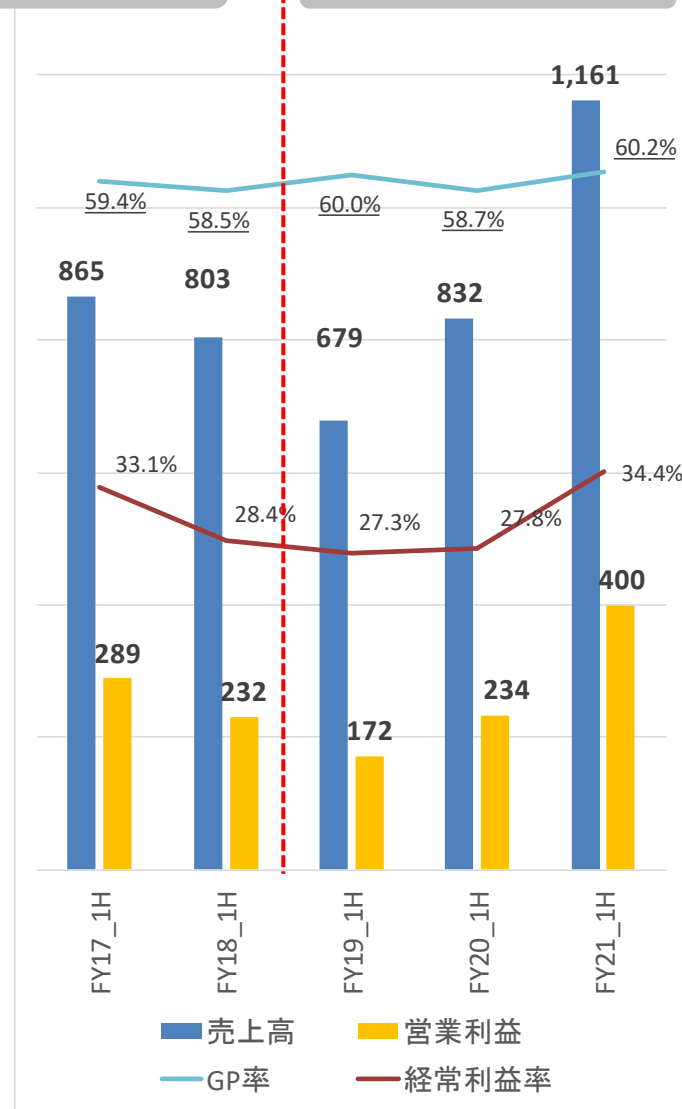


■ 上期業績は過去最高 改善等で収益性向上 (GP率 60.2%)

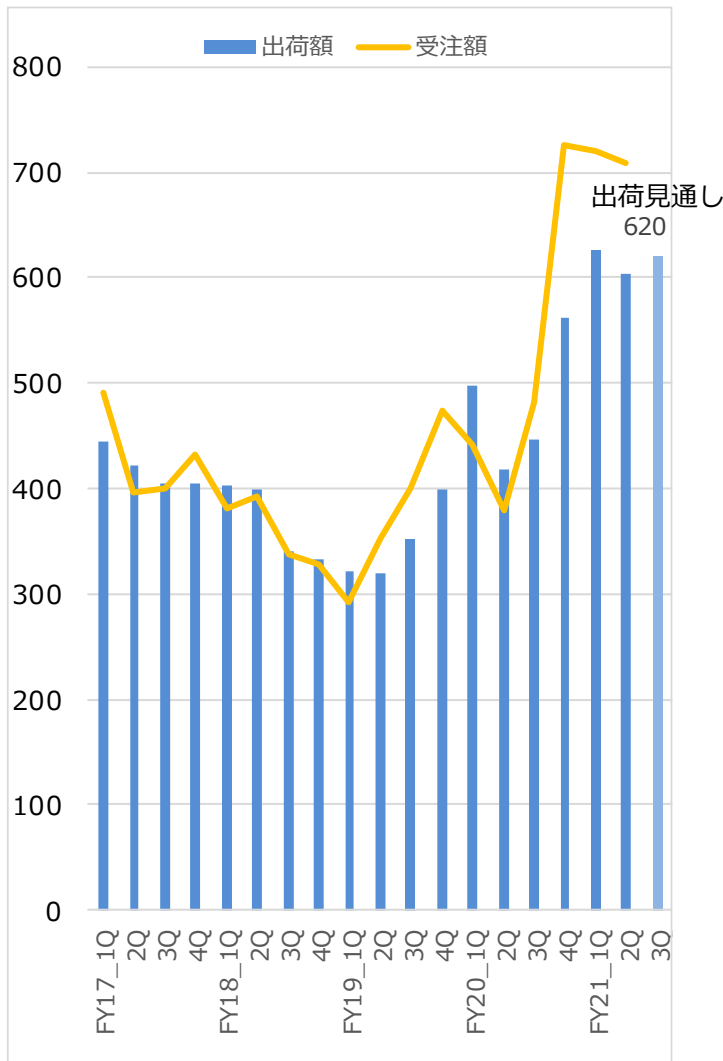
■ 中間配当は業績連動により199円 (前年116円から大幅増配)

上期推移 (億円)

検収基準



出荷額・受注額 四半期推移 (億円)



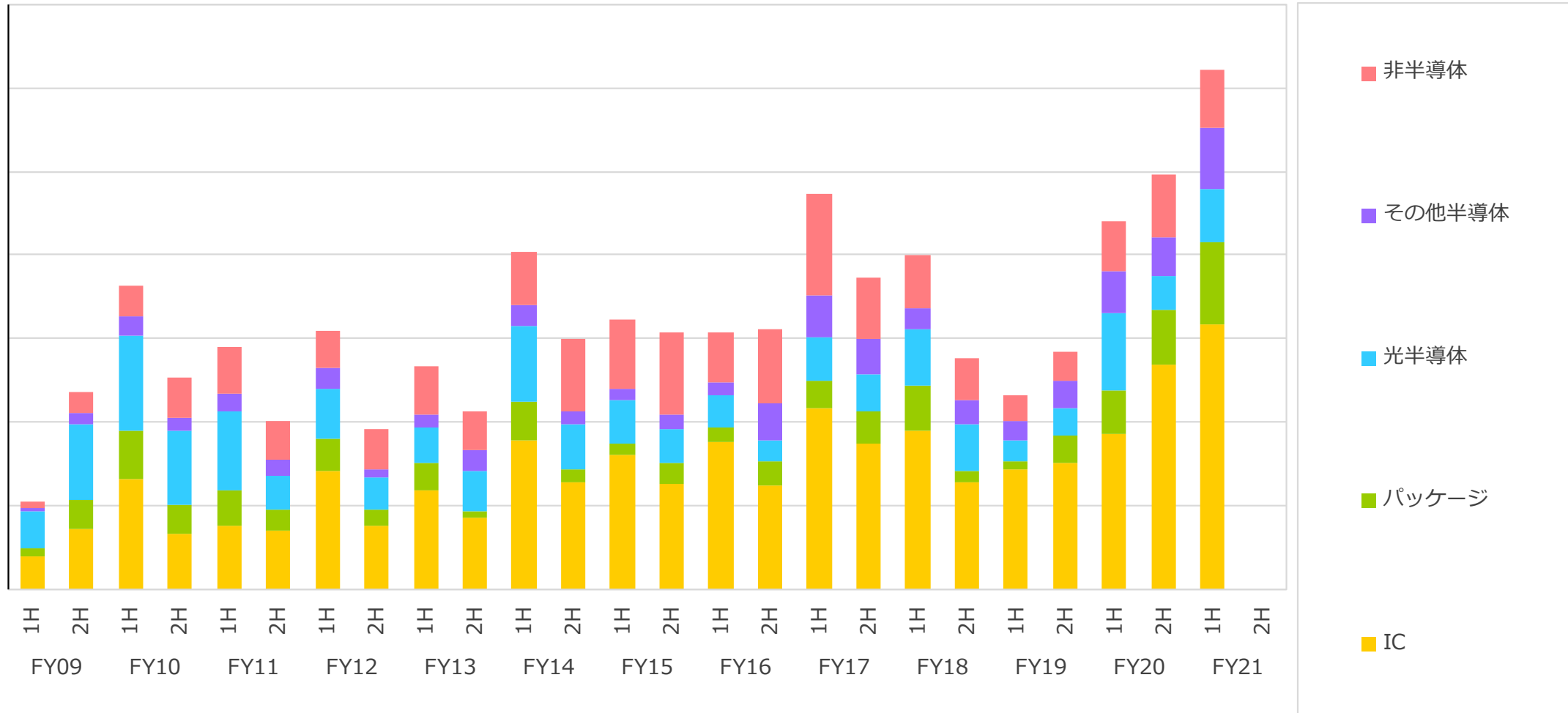
- 顧客の投資意欲は衰えず、出荷額は高水準継続を見込む
I C以外にパワー半導体など幅広い用途で需要が堅調
- 半導体の生産拠点見直しの動きもあり、
今後の設備投資動向とサプライチェーンの変化を注視
- 新型コロナや供給制約に対処しつつ、工場はフル稼働を継続
- 工場の拡張は一段落（8月に桑畑工場の新棟竣工済み）
今後も国内外拠点の拡張を機動的に検討していく方針
- 気候変動やガバナンス対応を含めた「会社を強くする」施策を継続
Will会計、PIM活動、DISCO VALUESをベースに各種課題に対応

- 半期推移グラフ

ダイサ用途別売上高(単体)

出荷額ベース

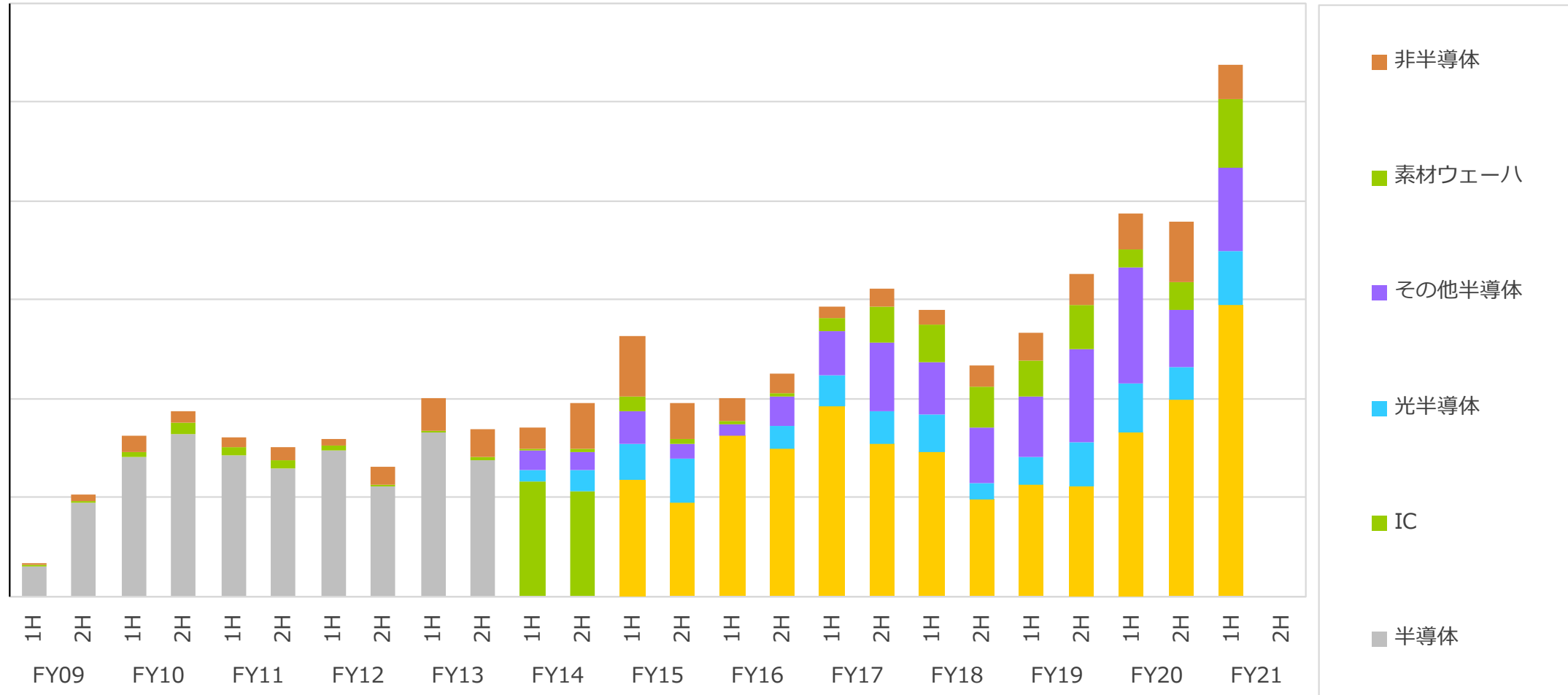
半期



グラインダ用途別売上高(単体)

出荷額ベース

半期



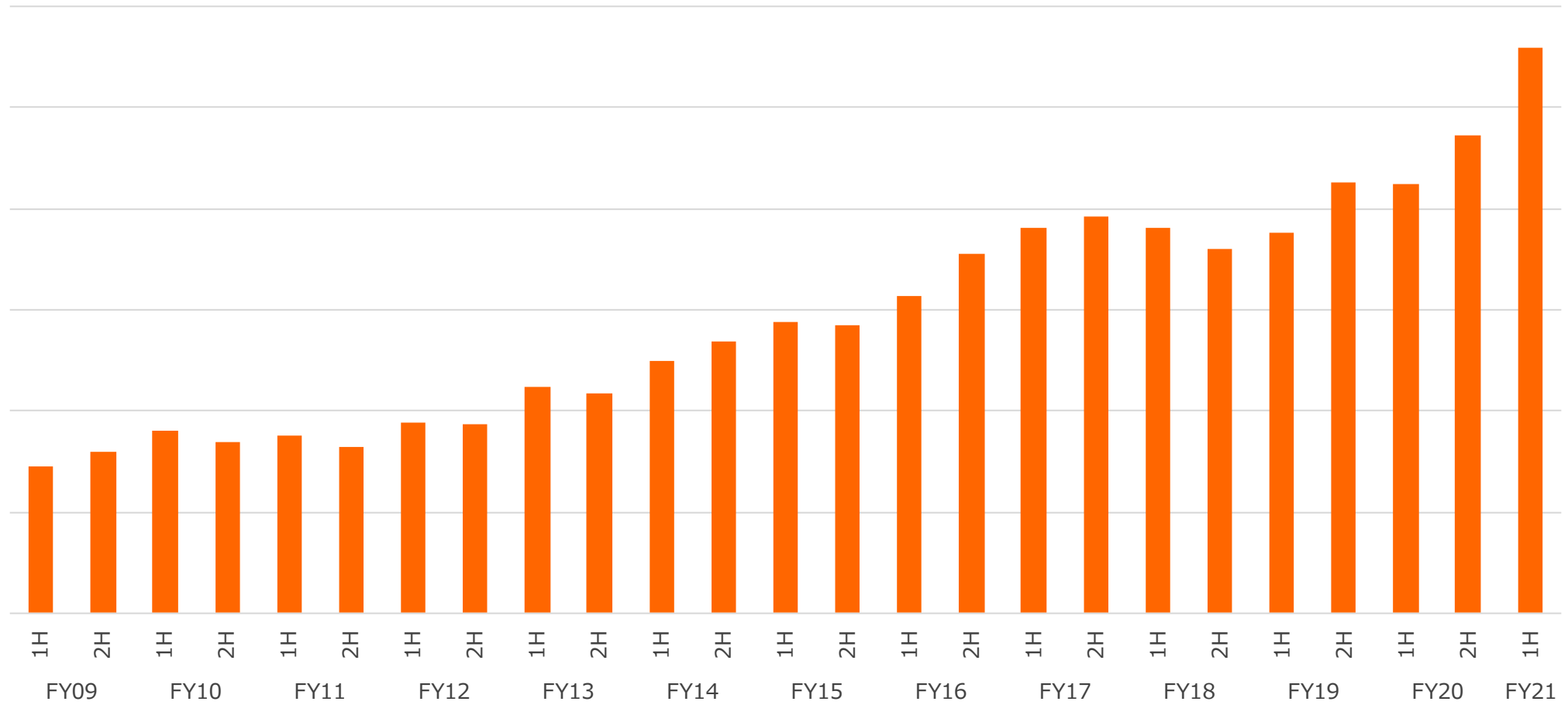
※FY14 1Qよりカテゴリを変更

『半導体』 → 『IC』 + 『光半導体』 + 『その他半導体』

『電子部品』 → 『非半導体』

出荷額ベース

半期



- 製品別・用途別詳細データ

出荷額ベース

	構成比	QoQ	YoY
■ 連結	2Q	2Q	2Q
精密加工装置合計	55%	-10%	48%
装置の内ダイサ	38%	-2%	51%
ブレードダイサ	25%	1%	55%
レーザー	13%	-7%	46%
装置の内グラインダ	17%	-25%	41%
薄化DGP	9%	-32%	18%
薄化以外	8%	-15%	84%
精密加工ツール	24%	5%	41%
その他	21%	8%	39%
出荷額合計	100%	-4%	44%

構成比	YoY
1H	1H
57%	37%
38%	37%
25%	48%
13%	22%
19%	38%
11%	36%
8%	43%
23%	32%
20%	29%
100%	34%

出荷額ベース

構成比		2020年度				2021年度	
製品	用途	20-1Q	20-2Q	20-3Q	20-4Q	21-1Q	21-2Q
ダイサ	1_IC	40%	45%	51%	56%	53%	49%
	2_パッケージ	11%	13%	14%	13%	16%	16%
	3_光半導体	24%	17%	10%	7%	9%	11%
	4_その他_半導体	11%	12%	10%	9%	10%	13%
	5_非半導体	14%	13%	16%	14%	13%	10%
ダイサ		100%	100%	100%	100%	100%	100%
グラインダ	1_IC	37%	51%	44%	58%	56%	53%
	2_光半導体	14%	11%	13%	5%	7%	14%
	3_その他_半導体	36%	22%	13%	17%	19%	11%
	4_素材ウエーハ	4%	6%	9%	6%	11%	15%
	5_非半導体	8%	11%	21%	13%	7%	7%
グラインダ		100%	100%	100%	100%	100%	100%

出荷額ベース

YoY		2020年度				2021年度	
製品	用途	20-1Q	20-2Q	20-3Q	20-4Q	21-1Q	21-2Q
ダイサ	1_IC	18%	46%	28%	135%	73%	69%
	2_パッケージ	466%	442%	91%	104%	92%	83%
	3_光半導体	293%	231%	82%	-3%	-51%	1%
	4_その他_半導体	197%	52%	77%	18%	13%	70%
	5_非半導体	128%	66%	113%	109%	20%	17%
ダイサ		92%	85%	53%	91%	31%	52%
グラインダ	1_IC	31%	67%	44%	103%	111%	43%
	2_光半導体	57%	156%	-25%	-23%	-30%	82%
	3_その他_半導体	196%	8%	-62%	-11%	-26%	-32%
	4_素材ウエーハ	-44%	-55%	-29%	-40%	268%	268%
	5_非半導体	108%	-4%	131%	51%	19%	-16%
グラインダ		63%	27%	-3%	35%	41%	37%

出荷額ベース

QoQ		2020年度				2021年度	
製品	用途	20-1Q	20-2Q	20-3Q	20-4Q	21-1Q	21-2Q
ダイサ	1_IC	32%	-2%	10%	64%	-3%	-4%
	2_パッケージ	34%	7%	1%	42%	25%	2%
	3_光半導体	154%	-36%	-47%	12%	29%	30%
	4_その他_半導体	16%	-6%	-23%	40%	12%	41%
	5_非半導体	55%	-16%	19%	36%	-11%	-18%
ダイサ		50%	-11%	-4%	49%	3%	3%
グラインダ	1_IC	32%	-2%	-15%	84%	37%	-34%
	2_光半導体	109%	-46%	19%	-43%	92%	40%
	3_その他_半導体	87%	-55%	-45%	91%	56%	-59%
	4_素材ウエーハ	-59%	-4%	52%	0%	151%	-4%
	5_非半導体	-1%	-5%	93%	-17%	-22%	-33%
グラインダ		37%	-28%	-3%	39%	43%	-30%

検収ベース

■ 構成比	FY2020				FY2021			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q		
日本	18%	16%	13%	10%	14%	12%		
アメリカ	6%	6%	7%	9%	7%	7%		
アジア	71%	71%	73%	75%	73%	76%		
シンガポール	9%	7%	8%	10%	8%	12%		
台湾	20%	23%	19%	18%	15%	19%		
韓国	12%	10%	11%	10%	12%	7%		
中国 ※	29%	27%	34%	35%	35%	37%		
その他	1%	4%	2%	2%	2%	1%		
ヨーロッパ	4%	7%	8%	7%	6%	4%		
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

※外資メーカー現地工場向け含む

■単純平均 / 為替レート		USD	EUR
FY19	19-1Q	110.8	123.6
	19-2Q	107.6	120.4
	19-3Q	108.8	119.9
	19-4Q	109.3	121.0
FY19_通期		109.1	121.3
FY20	20-1Q	107.8	118.2
	20-2Q	105.9	123.6
	20-3Q	104.8	123.6
	20-4Q	104.9	127.7
FY20_通期		105.8	123.3
FY21	21-1Q	109.8	131.8
	21-2Q	110.0	130.4
	21-3Q	105.0	125.0 想定

連結受注_月次推移	
2020年7月	121 億円
2020年8月	121 億円
2020年9月	136 億円
2020年10月	143 億円
2020年11月	171 億円
2020年12月	167 億円
2021年1月	190 億円
2021年2月	238 億円
2021年3月	298 億円
2021年4月	277 億円
2021年5月	203 億円
2021年6月	240 億円
2021年7月	256 億円
2021年8月	208 億円
2021年9月	245 億円